

4525HA/4525HB(75D)聚氨酯树脂封装材料



一、简介:

4525HA/4525HB 系双组份绝缘封装材料, 具有低应力、优良的耐冷热冲击特性、稳定的电气性能, 可在室温或者低温固化。

二、常规性能:

测试项目	测试方法或条件	4525HA	4525HB
外观	目测	黄色液体	客户指定颜色液体 (默认黑色)
粘度	25°C mPa·s	100±50	3000±500
密度	25°C, g/ml	1.20±0.05	1.50±0.05
保存期限	室温密封	六个月	六个月

三、使用工艺:

项目	单位或条件	4525HA/4525HB
混合比例	重量比	25: 100
适用期*	25°C, min	20~30
固化条件	°C/h	60/3~4 或 25/24

\*适用期到 5Pa·S 为止。

四、用途:

适用于中小型电子元器件的灌封, 如: 中频电炉 (默认黑色)、互感器 (默认红棕色)、高档电容器、变压器、点火控制器、滤波器等等。

五、建议使用工艺:

1、预热：被浇注器件请于 70~80℃烘 1~2 小时。也可降低温度，延长加热时间，以除去器件湿气。

4525HA/4525HB 在低温下，粘度会变高，A 料易结晶。请预热材料至 25~45℃。便于使用。

2、B 剂在储存过程中会有分层或少量沉淀，请搅拌均匀后使用。

3、混合：按比例称量 A、B 料，搅拌时垂直搅拌棒，顺时针(或逆时针)同方向搅拌 2~3 分钟，尽量减少搅入空气。注意容器底部、边缘部也要搅拌均匀，否则会有局部不固化现象。

4、脱泡：对于灌封表面要求光洁无气泡者，混合料应边搅拌边抽真空( $\leq -0.1\text{mpa}$ )可顺利脱去气泡。采用机械计量混合灌封者，省略步骤 3、4。

5、浇注：将混合料浇入器件中，器件结构复杂、体积大者，应分次浇注。浇注气泡可用热风枪等吹扫。可消除表面浮泡。

6、固化：25℃/24h，或者 60℃/3-4h。可固化。温度低应酌情延长固化时间。本品对湿气敏感，潮气会造成固化起泡。操作环境建议控制在  $23\pm 3^\circ\text{C}$ ，相对湿度  $< 70\%$ 。

#### 六、固化后特性：

项目	单位或条件	4525HA/4525HB
硬度	Shore-D, 25℃	75±10
吸水率	24h, 25℃%	<0.3
体积电阻率	$\Omega \cdot \text{cm}$	$>1 \times 10^{14}$
表面电阻率	$\Omega$	$>1 \times 10^{14}$
拉伸强度	Mpa	>3
断裂伸长率	100%	>50
阻燃性	UL-94	V-0
绝缘强度	KV/mm	>20
应用温度范围 <sup>#</sup>	℃	-40~130 (Class B)

#最大工作温度是根据有效实验结果得出。最终的使用温度必须由器件结构的耐热等级所决定。耐高温等级 B 已通过测试 (IEC 60216 / IEC 60085)。

#### 七、贮存、运输及注意事项：

1 此类产品非危险品，按一般化学品贮运，产品贮存期见包装桶。

2 常温 (5~35℃) 常湿 (45~85%RH)，避光阴暗密封处，贮存。

3 请看准所使用产品型号，然后对号入座；准确称量后，请充分搅拌均匀。

八、包装规格：

A 料包装为 6KG ； B 料包装为 24KG 金属容器。

\*注：以上性能数据为该产品于湿度 70%、温度 25℃时测试之典型数据，仅供客户使用时参考，并不能完全保证于某个特定环境时能达到的全部数据。敬请客户使用时，以实测数据为准。